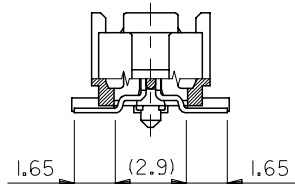
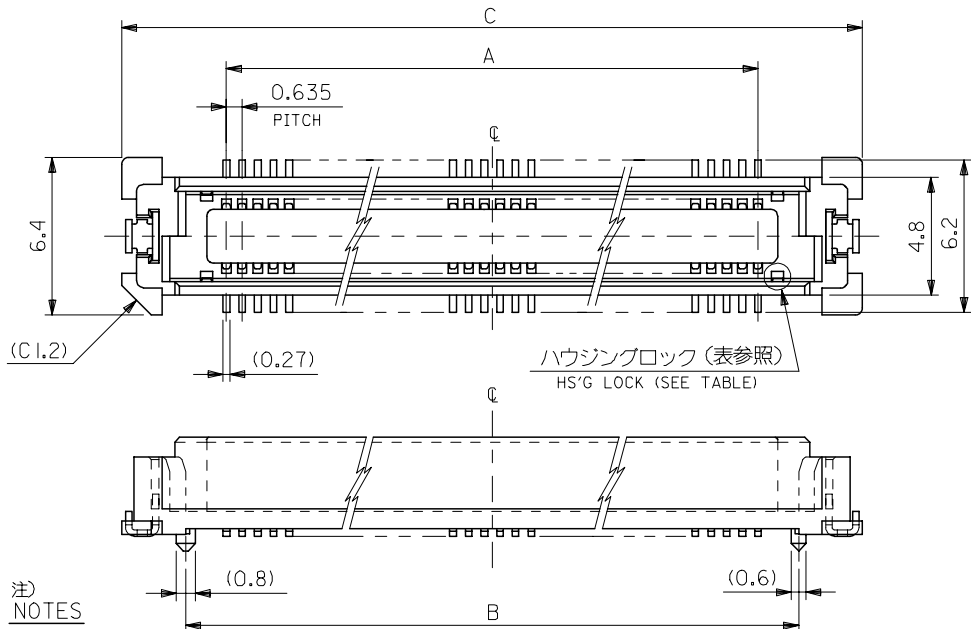
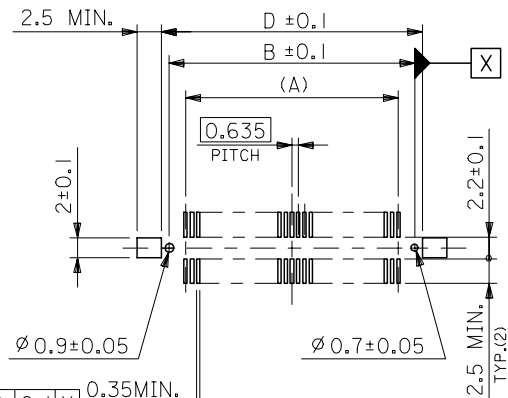
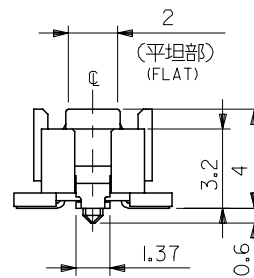


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



半田付け部詳細図
DETAIL FOR SOLDERING AREA



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE:2-1)

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング : ガラス入りLCP、白色、UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, GLASS FILLED, WHITE, UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
補強金具 : 銅合金 (t=0.25)
FITTING NAIL: COPPER ALLOY
- メッキ仕様 PLATING
ターミナル: 接点部 : 金メッキ 0.25 µmMIN.
TERMINAL: CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
半田付け部 : 錫メッキ 2.0 µmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN 2.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ : ニッケルメッキ 2.0 µmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 MICROMETER MINIMUM
補強金具: 銅メッキ 1.0 µmMIN.
FITTING NAIL: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.0 µmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
- テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テール及び金具の平坦度は、0.1以下とする。
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- エンボス対応済みの極数については、SD-52760-014を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-52760-014.

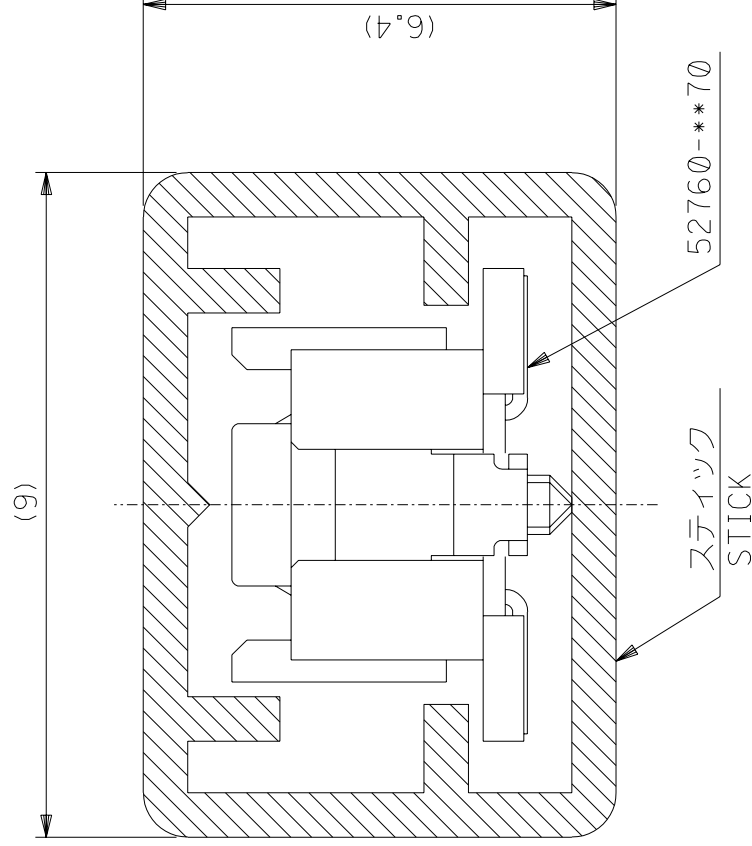
5. 本製品は52760-***Oの鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52760-***O.

10 mm	53553 SERIES
9 mm	53552 SERIES
8 mm	53551 SERIES
7 mm	53481 SERIES
6 mm	53467 SERIES
5 mm	53475 SERIES
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

無し NO	80.47	84.07	78.87	75.565	—	52760-2479	52760-2470	240	—
	67.77	71.37	66.17	62.865	—	-2079	-2070	200	○
	61.42	65.02	59.82	56.515	—	-1879	-1870	180	○
	55.07	58.67	53.47	50.165	—	-1679	-1670	160	○
	48.72	52.32	47.12	43.815	—	-1479	-1470	140	○
	42.37	45.97	40.77	37.465	—	-1279	-1270	120	○
	36.02	39.62	34.42	31.115	52760-1078	-1079	-1070	100	○
	32.85	36.45	31.25	27.94	-0978	-0979	-0970	90	○
	29.67	33.27	28.07	24.765	-0878	-0879	-0870	80	○
	26.5	30.1	24.9	21.59	-0778	-0779	-0770	70	○
有り YES	25.86	29.43	24.26	20.955	-6878	-6879	-6870	68	○
	23.32	26.92	21.72	18.415	-0678	-0679	-0670	60	○
	20.15	23.75	18.55	15.24	-0578	-0579	-0570	50	○
	16.97	20.57	15.37	12.065	-0478	-0479	-0470	40	○
	13.8	17.4	12.2	8.89	-0378	-0379	-0370	30	○
	10.62	14.22	9.02	5.715	52760-0278	52760-0279	52760-0270	20	○
ハウジングロック HS'G LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.	標準寸法 AVAILABLE

REVISED EC NO: J2007-0439 DRWN: NABE1 CHKD: KTOYODA APPR: NUKITA	DESCRIPTION 2006/08/22 2006/08/25 2006/09/05	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY Y. WADA	DATE '04/02/26	TITLE 0.635 PITCH B-T0-B S/T REC. HSG ASSY -LEAD FREE- MOLEX INCORPORATED		
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/26			
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/26			
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.				
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-52760-013		1 OF 1	
A	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

SD-52760-015



NOTES ()

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長 : 600 ± 2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚 : 0.6 ± 0.2
THICKNESS
4. 量産対応済の極数については、
SD-52760-013を参照下さい。
SEE SD-52760-013 FOR AVAILABLE ITEMS.
5. 本製品は52760-**-**9の鉛フリー品
である。

C

U

5 IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角 度	ANGLE	公差
30° 以上	30° OVER	±0.3
10° 以上 30° 未満	10° OVER 30° UNDER	±0.25
10° 未満	10° UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

MODEL NO.	52760-**-79
-----------	-------------

				/		材料 MATERIAL	
				/		スティック：ポリ塩化ビニル STICK : P.V.C	
				/		仕上げ FINISH	-- --
				/		適用電線範囲 WIRE RANGE	-- --
				/		被覆外径 INS. RANGE	-- --
				/		DRAWN BY '04/02/26	CHK'D BY '04/02/26
				/		Y.WADA	M.SASAO
				/		APP'D BY '04/02/26	R SCALE
				/		M.SASAO	SCALE -- --
				/		日付 DATE	
				/		DR.	CHK.
				/		Y-W / M-S	
①						新規作成 RELEASED (J2004-2690)	
記号						変更内容 REVISION RECORD	

 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 52760-**-70 STICK PACKAGING -LEAD FREE-	
DWG. NO.	REV
SD-52760-015 0	

A

 ∇

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM MOLEX(JAPAN).
本図面は日本モリス（株）の所有する権利を含有するもので、当社の許可なく複製を禁止する。
CNI-0110-02